



# EVG®150

## 全自動レジスト プロセス装置



### イントロダクション

高スループット、高性能で最大ウェーハサイズ300 mmに対応するEVG®150- 全自動レジストプロセス装置です。

完全モジュール型プラットフォームとして設計されたEVG150は、スピン/スプレー/現像プロセスでの高スループットを実現します。EVG150 は、高い塗布均一性と優れた再現性を保証します。従来のスピン塗布方式では限界のあった高段差形状への塗布も、EVG独自の OmniSpray技術によって可能となりました。

### テクニカルデータ

ウェーハ径 (基板サイズ)	300 mmまで
利用可能なモジュール	- スピン塗布 / OmniSpray® / 現像 - ベーク / 冷却
ウェーハ搬送オプション	- シングル/デュアル・エンドエフェクター / エッジ搬送 / ウェーハ反転機構 - ゆがみ・反り・薄ウェーハの搬送
ディスペンスオプション	- 52000 cP までの幅広い粘度に対応する各種レジスト・ディスペンス・ポンプ - 定圧ディスペンサ・システム - EBR / BSR / ブリウエット / ポウル洗浄 / 液中ブライミング

### 特長

- 300 mmまでの基板サイズに対応
- 最大6つのプロセスモジュール
- ベーク/冷却/蒸気プライム処理用プレートは最大 20段まで指定自由
- ロードポートまたはカセットを4 台まで搭載可能
- 極端な高段差構造形状のコンフォーマル塗布を可能にする超音波霧化技術OmniSpray®
- オプションのNanoSpray™ モジュール搭載により、最大 1:10のアスペクト比、深さ300-µmの垂直側壁のコンフォーマルコーティングを実現
- 多様な材料を選択可能
- メガソニック技術による洗浄、ソノケミカル処理および現像プロセスの効率化(数時間を数分に短縮)
- 生産現場で実証済みのデュアルアーム機能を備えた精巧な搬送システムを搭載し、高スループット処理を保証
- スマートなプロセス制御とデータ分析機能
  - 装置とプロセスのパフォーマンス追跡とデータ解析機能
  - 並列タスク/キューイングタスク処理機能
  - スマート搬送機能
  - 発生・アラーム分析機能
  - スマートメンテナンスとトラッキング機能

### お問い合わせ

イーヴィグループジャパン株式会社  
〒240-0005  
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134  
横浜ビジネスパークイーストタワー1F  
+81 45 348 0665



Sales@EVGroup.jp



www.EVGroup.com